

Gemch

溅射靶材
Sputter Target

研发
Development

解决方案
Technical Solutions



基迈克材料科技

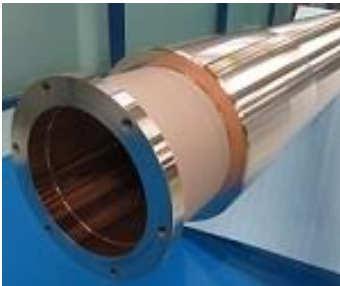
AMSF™ 技术金属铜溅射靶材

概览 | OVERVIEW

基迈克采用先进多级形变(AMSF™)技术是特别用于制备平板显示领域用金属铜和铜合金靶材的先进生产工艺。通过采用 AMSF™ 工艺制备的金属铜靶材具备细微且均匀的粒度并且具备低氧含量的特性。

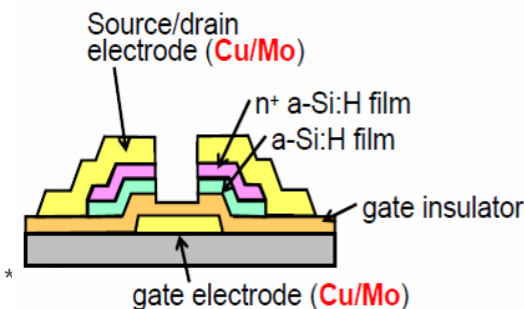
先进多级形变(AMSF™)工艺是我们向客户提供优质稳定的金属铜溅射靶材的保障,通过对材料本体性能的控制以避免在溅射成膜过程中出现打弧和掉渣等不良现象,以确保获得均匀而且无颗粒的高质量膜层。

先进多级形变(AMSF™)技术是基迈克技术团队通过多年的研发所获得的成果,AMSF 是将熔铸挤压技术应用于金属铜溅射靶材生产的突破性成果的体现,不仅可以生产高质量的平面金属铜靶材而且同样可以生产高性能旋转铜靶材。



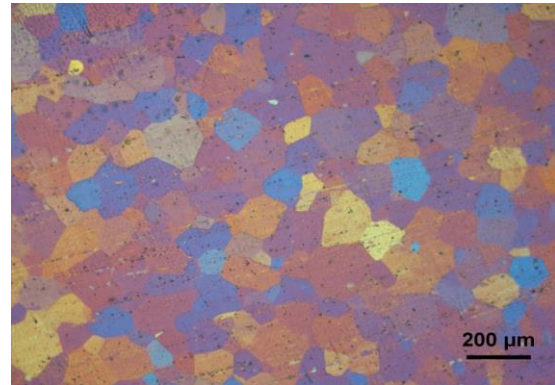
应用市场 | APPLICATION MARKET

凭借 AMSF™ 工艺所获得的质量产品优势,基迈克材料科技生产的 G11 代金属铜溅射靶材已经通过美国应用材料公司的认证,应用于沉积不同世代液晶面板以及触控面板金属布线层,并且得到客户的高度认



质量优势 | FEATURES

- 高纯度 $\geq 99.99\text{wt}\%$
- 细微晶粒度 $\leq 100\mu\text{m}$
- 低含氧量 $\leq 20\text{PPM}$



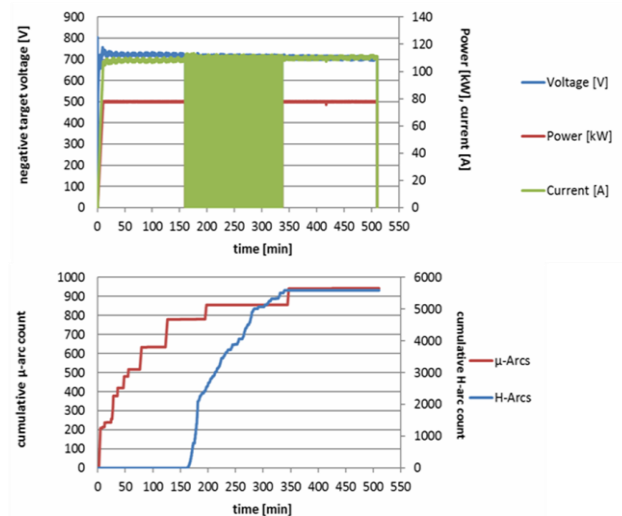
平均晶粒 85um

配置 | CONFIGURATION

基迈克可以提供目前主流 PVD 系统的不同配置的平面和旋转金属铜靶材,产品规格满足最大 G11 世代产线所需的规格,适用系统主要包括:

- AKT
- ULVAC
- Iruja

性能 | PERFORMANCE



*数据来源美国应用材料(AKT)公司

高性能溅射靶材生产商,基迈克材料科技是您值得信赖的金属铜靶材供应商和行业合作伙伴。

AMSF™ 技术金属铜溅射靶材 AMSF™ Technology Cooper Sputter Target

纯度 Purity
≥ 99.99wt%

晶粒 Grain size
<85um

相对密度 Relative Density
≥ 99.5wt%

表面质量 Surface Quality
Ra < 1.2 um

杂质 Impurities

H																								
10																								
Li	Be	金属杂质分析采用 ICP *气体杂质分析采用 LECO 杂质含量单位为 PPM										B	C*	N*	O*	F								
																							10	
Na	Mg																						Al	Si
																10								
K	Ca	Sc	Ti	V	Cr	Mn	Fe	Co	Ni	Cu	Zn	Ga	Ge	As	Se	Br								
					10		10		10															
Rb	Sr	Y	Zr	Nb	Mo	Tc	Ru	Rh	Pd	Ag	Cd	In	Sn	Sb	Te	I								
Cs	Ba	La	Hf	Ta	W	Re	Os	Ir	Pt	Au	Hg	Tl	Pb	Bi	Po	At								
Fr	Ra	Ac		Ce	Pr	Nd	Sm	Eu	Gd	Tb	Dy	Ho	Er	Tm	Yb	Lu								

如需了解更多产品信息，请联系基迈克销售人员 FPD@gemch.com

关于基迈克

基迈克材料科技致力于为薄膜沉积领域提供高性能薄膜材料以及周边产品和服务。我们以先进材料技术驱动业务发展，通过持续不断的技术创新为各个业务领域的客户提供高附加值的产品，在立足于满足客户当前需求的同时更关注来自未来的挑战。欲了解更多信息，请访问：www.gemch.com